

ネプコンジャパン2018

第19回半導体・センサパッケージング技術展出展

1 期間・会場

開催期間 2018年1月17日～1月19日(3日間)

会場 東京ビッグサイト

東光高岳ブース 東展示場 3ホール E27-48

2 概要

本展示会は、半導体／実装・検査機／LED・レーザ／電子部品・材料にかかわるあらゆる製品・技術・サービスの会社が一堂に出展するアジア最大級の「エレクトロニクス専門展」である。

同時に、自動車／産業用ロボット／ウェアラブル端末／IoT関連の展示会も併設されており、会場全体で3日間の来場者数は114,380名となり、前年より4,146名増と大盛況となった。

東光高岳ブースでは、商品の認知度アップと受注機会拡大を目的に、温度可変反り検査装置 HVI-8000-EC の実機展示およびプレゼンテーション資料にてPRを行った。

東光高岳ブースにも多数のお客さまにお越しいたごき、50社以上からお問い合わせがあり、新しい市場の開拓と新規受注獲得に向けてフォロー活動を実施している。



図1 東光高岳ブース

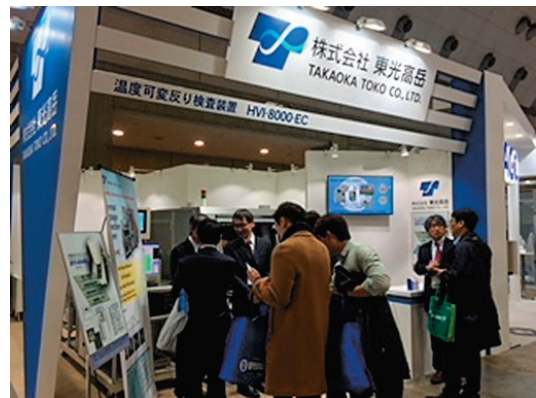


図2 来訪者対応

【出展品】



図3 温度可変反り検査装置 HVI-8000-EC

温度可変反り検査装置 HVI-8000-EC とは……

温度制御プロファイル(−55℃～220℃)を作成し、専用のトレイに載せられた基板を、多様な温度環境下で、高速・高精度に基板反り検査が可能。

基板反り検査とともに、バンプ／ボール／LGAの高さや、その平坦度も同時に測定が可能。

バンプ形状は、ラウンド／フラッタニングどちらも計測可能。

LGA : Land Grid Array